

ZERO[®]-TSP600R-K80-G30导热软垫

特点/好处

- 热传导率=8.0W/mk
- 超好的贴服性,低硬度
- 电气绝缘
- 优异的柔软度

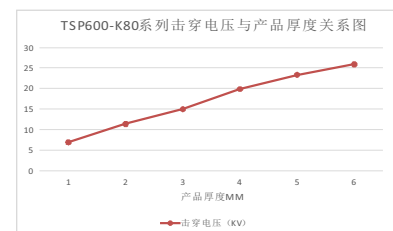
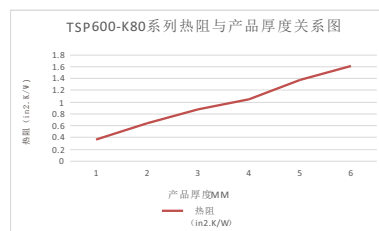
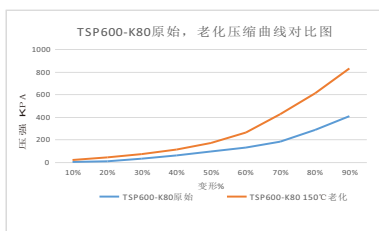
TSP600-K80系列是一种全新的、高性能的导热间隙填充材料。除了高热传导能之外, TSP600-K80在与散热器或其它发热体相结合进, 会充分的弥散于表面, 使产品发挥最佳效果



PROPERTY 特性	典型值	测试方法 Test Method				
颜色	灰色	Visual				
厚度 Thickness (mm)	1~10	ASTM D374				
密度 Density (g/cc)	3.5	ASTM D792				
硬度 Hardness Bulk Rubber (Shore c)	30 (@6MM)	ASTM D2240				
撕裂强度 (N/m)	0.6 (@3MM)	ASTM D624				
抗张强度 Tensile strength (Psi)	18 (@3MM)	ASTM D412				
延伸率 Elongation (%)	60 (@3MM)	ASTM D412				
耐温 Continuous Use Temp(°C)	-40 to 150	--				
电气性能						
耐电压 Dielectric Breakdown Voltage (KV/AC)	6 (@3MM)	ASTM D149				
介电常数 Dielectric Constant (1000 Hz)	5.8 (@3MM)	ASTM D150				
体积电阻 Volume Resistivity (Ohm-meter)	10 ¹⁰ (@3MM)	ASTM D257				
防火等级 Flame Rating	94V-0	U.L				
热性能						
导热系数 Thermal Conductivity(W/m-k)	8.0 ± 0.5	ASTM D5470				
热阻特性VS压力 (厚度为1MM样片为参考)						
压力 (psi)	2	5	10	20	30	40
热阻 (°C · in ² / W)	0.65	0.55	0.49	0.44	0.41	0.39
压缩比例 (%)	15%	27%	43%	72%	85%	91%
保持期 (1年) Retention period	阴暗条件储存, 温度 ≤ 40° C, 湿度 ≤ 70% 堆放不超过7层, 总高度低于1米					

典型应用

- LCD显示模组部份与塑胶外框结合部的四周;
- 大型通信设备及周边配套设备;
- 计算机、平板电脑、智能手机;
- 光伏发电设备及周边;
- 其它特种行业;
- 新能源电动电池;



以上数据由零度导热实验室提供, 该实验室保留最终解释权。